

## 直接描画装置「LeVina」のラインアップを拡充 ～露光波長375nm対応モデルを7月に発売～

株式会社SCREENホールディングスはこのほど、5G／ポスト5G関連やIoTインフラを中心に拡大が続くICパッケージ基板やFOPLP<sup>※1</sup>などに対応した、次世代パターン用直接描画装置「LeVina（レビーナ）」の2 $\mu$ m対応モデルを開発。2023年7月に販売を開始します。



### LeVina（2 $\mu$ m対応モデル）

☆この画像の印刷用データ（解像度300dpi）は、  
下記URLよりダウンロードできます。

([www.screen.co.jp/about/nr-photo\\_2023](http://www.screen.co.jp/about/nr-photo_2023))

近年、5G／ポスト5G関連やIoTインフラ、DX（デジタルトランスフォーメーション）やGX（グリーントランスフォーメーション）の進展に伴い、パッケージ基板技術にはさらなる高性能化が求められ、高精細な描画性と高生産性を両立できる直接描画装置へのニーズが高まっています。

このような需要を背景に当社は、次世代パターン用直接描画装置「LeVina」の2 $\mu$ m対応モデルを開発し、7月に販売を開始します。この装置は、2022年4月に発売した従来モデルにおける、高速ステージやスキャンアライメント機能による高生産性を活用しつつ、光学系のユニットを刷新。露光波長を375nmとしたことで、世界最高水準となる解像度2 $\mu$ mを実現しました。これにより、従来のターゲットであるICパッケージ基板だけでなく、FOPLPや2.1D／2.3D<sup>※2</sup>といわれるチップレット<sup>※3</sup>を実現するための先端半導体パッケージへの活用が期待できます。また、露光波長を375nmにしたことにより、ドライフィルムレジストだけでなく、液状レジストの露光にも対応。405nm波長の従来モデルに追加してラインアップを拡充することで、材料やアプリケーションに応じて装置を選択することが可能になります。さらに、すでに405nm波長の従来モデルを導入しているユーザーも、光学系ユニットを入れ替えることで375nm波長へ改造可能など、用途に応じたフレキシブルな生産ラインの構築に寄与します。

当社は、今回の「LeVina」のラインアップ拡充により、5G／ポスト5G関連やIoTインフラを中心に拡大が続くパッケージ基板市場へのビジネス展開を加速させるとともに、今後も半導体パッケージ業界のさまざまなニーズに応え、同業界の発展に貢献していきます。

※1 FOWLPの製造方法を、ウエハーよりも大きなパネルに適用した半導体パッケージ。

※2 有機基板表層に有機インターポーザーを一体化させた構造の半導体パッケージ。

※3 従来は、1つのチップにCPU／GPU／メモリーなどの機能を詰め込んだSoC（System on Chip）を製造していたが、それぞれ個別に製造した機能別チップをパッケージ内で接続することにより、コストを抑えながら性能を引き上げる技術。

### JPCA Show 2023

2023年5月31日（水）から6月2日（金）まで東京・有明の東京ビッグサイトで開催される「JPCA Show 2023」に出展します。 URL：[www.jpccashow.com/show2023/index.html](http://www.jpccashow.com/show2023/index.html)

#### ● 本件についてのお問い合わせ先

株式会社SCREENホールディングス コーポレートマーケティング室 Tel: 075-414-7698 [levina@screen.co.jp](mailto:levina@screen.co.jp)